

A股证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2026-020

港股证券代码：02631

证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于签订战略框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 履约的重大风险及不确定性：**山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与协议各方基于未来合作意向签署框架性、原则性协议，具体合作事项、实施进度及金额存在不确定性，不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
- 对上市公司当年业绩的影响：**本协议属于框架性协议，预计对公司2026年度及未来业绩不构成直接影响，对公司业绩的具体影响需视下一步具体项目推进和实施情况来确定。

一、框架协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

本次项目合作涉及多方，鉴于合作方名称涉及商业保密信息，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规的规定，对方名称等基本信息予以豁免披露。

合作方一：主要从事碳化硅芯片研发、生产及相关半导体业务；

合作方二：主要从事电力科技、功率半导体相关资产运营与产业配套；

合作方三：主要从事汽车系统及零部件研发、生产与市场推广；

合作方四：主要从事产业投资、战略资本运作。

公司：主要从事碳化硅衬底材料研发、生产与销售。

（二）签订协议已履行的审议决策程序

本协议2026年3月在上海签订，为基础性框架协议，不涉及具体的交易金额，无需提交公司董事会或股东会审议。公司将根据后续合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序以及信息披露义务。

二、框架协议的主要内容

（一）合作的背景与目标。

国内碳化硅（SiC）产业链正处于快速发展期，亟需上下游协同，提升自主可控能力与整体竞争力。合作五方在新能源汽车、半导体、先进制造、产业投资领域分别拥有技术、产能、市场、资本及政府资源优势，具备高度互补性。公司希望通过深度战略绑定，打通材料、芯片、车规应用、产能扩张、资本支持全链条，共同抢抓行业机遇，协同推进8英寸碳化硅芯片生产线项目落地与政策支持，快速提升芯片产能，从而推动碳化硅全产业链自主可控与规模化、高质量发展。

（二）合作范围与内容

为充分发挥各方在各自领域的优势，深化战略协同，围绕碳化硅产业链开展项目、业务、资本合作。

（三）合作机制

为确保有效沟通与协作，各方同意建立定期或不定期的会晤机制，通过高层会议、项目联络人会议等方式，就合作事宜进行磋商。

对于本协议框架下的具体合作项目，各方应另行协商并签订具体的项目协议。

（四）协议生效条件

本协议自双方签署之日起生效。

三、对上市公司的影响

本协议有助于巩固公司在碳化硅衬底领域的产业地位，进一步完善上下游协同，拓展市场应用场景，提升综合竞争力，符合公司长期发展战略。协议为框架性约定，对公司当期经营业绩不构成重大影响。

四、重大风险提示

本次签署的协议为战略合作意向的框架性协议，后续业务合作的具体实施内容和进度将以另行签订的实际业务合同为准。本协议的执行情况尚存在不确定性。公司将根据协议履行情况及后续合作进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 28 日